

	<b>江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片</b> <b>W2XN909</b>	文件编号	XS-J-001
	<b>低频放大管壳额定双极型晶体管</b>	版本号	18-A5-06
		页 码	1/3

## 1 主要用途及主要特点

### 1.1 主要用途

用 W2XN909 封装的成品管主要用于 PC 电源及其相关的电子电路中。

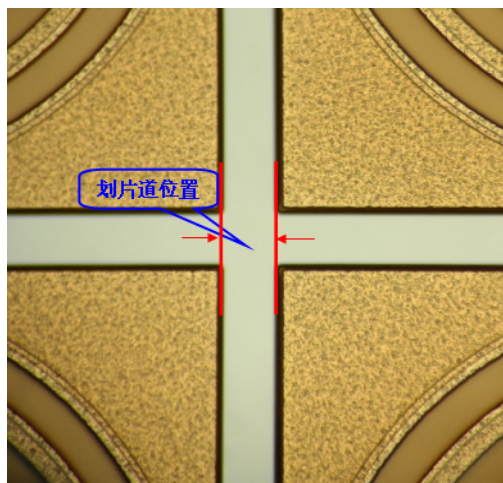
### 1.2 主要特点

- 开关损耗低、可靠性高
- 高温特性好
- 反向漏电小

## 2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	2.40×2.40	
	芯片厚度 (μm) (推荐)	250±20	
	划片道*尺寸 (μm)	60	
	键合区面积 (μm <sup>2</sup> )	基 区	320*593
		发射区	320*460
	钝化层		PIA
	正面电极	金属	铝
		厚度 (μm)	5±1.0
	背面电极	金属	银
	装片要求 (推荐)		焊料
	硅片直径 (mm)		φ 125
键合要求 (推荐)		铝丝; φ 150 μ m; E、B 区各一根	

\* 划片道位置示意图:



## 3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

### 3.1 极限值

除非另有规定,  $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	$V_{CB0}$	900	V	推荐封装形式: TO-220 推荐成品型号: C5027
集电极-发射极电压	$V_{CE0}$	800	V	
发射极-基极电压	$V_{EB0}$	7	V	
集电极电流	$I_C$	0.5	A	
耗散功率( $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ )	$P_{tot}$	2	W	
结温	$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

江阴新顺微电子有限公司

地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电 话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

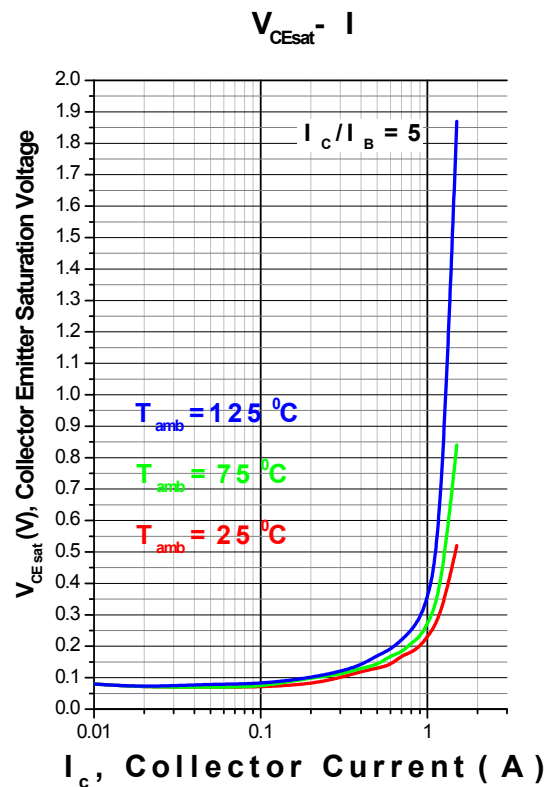
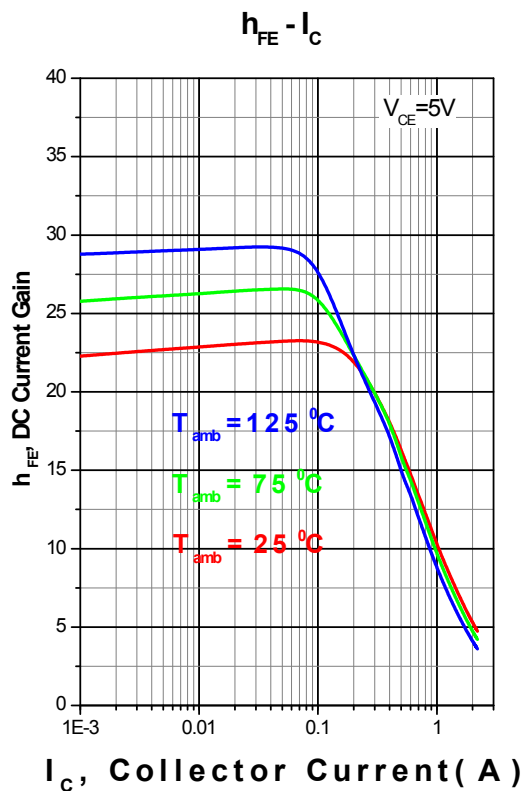


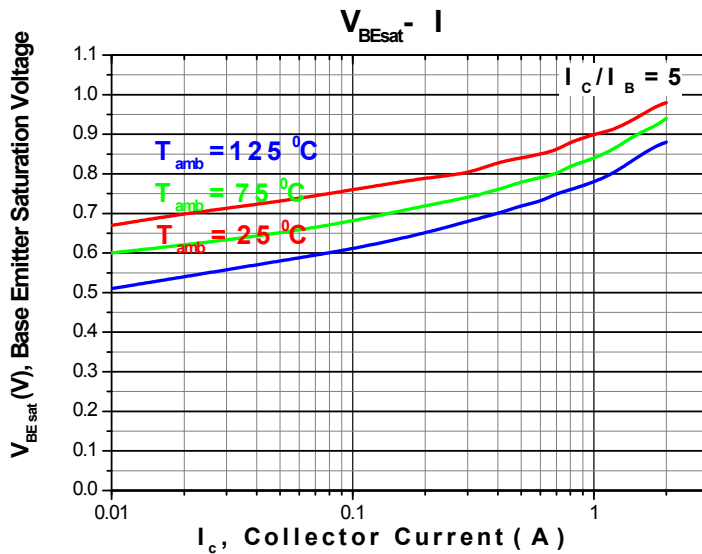
### 3.2 电参数

除非另有规定,  $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=900\text{V}, I_E=0$			100	$\mu\text{A}$
发射极-基极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=7\text{V}, I_C=0$			10	$\mu\text{A}$
共发射极正向电流传输比的静态值	$h_{FE}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=100\text{mA}$	15		30	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CEsat}$	$I_C=1.0\text{A}, I_B=200\text{mA}$			1	V
存储时间	$t_S$	$I_C=250\text{mA}$ (UI9600)	2		8	$\mu\text{S}$
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.2\text{A}$ $f=1\text{MHZ}$	5			MHz

### 3.3 典型特性曲线





注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度  $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度  $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。